

ワイヤレス・ターミナルズ ソリューション・ガイド

OMAP™ Overview

もし携帯端末設計者が、次世代の端末とサービスを望んでいるユーザーの興味をそそるマルチメディア・リッチでもっとも完璧なソリューションをお探しなら、TIのOMAP™ プラットフォームがその解答です。OMAP™ プラットフォームは、メディアのストリーミング、セキュリティ、インタラクティブ・ゲーム、モバイル・コマース、位置サービスといったアプリケーションの実現を2.5G、3Gおよび3.5Gのアプリケーションに必要なリアルタイム処理性および低消費電力性を満たした上で、豊富なプロセッサ・ラインアップ、ソフトウェア、サポートを包括的に提供します。

OMAPプラットフォームはアプリケーション・プロセッサとして汎用端末から高い電力効率を備えたハイエンドのマルチメディア・

スマートフォン、その他のインターネット・アクセス機器まで、幅広いモバイル機器に最適です。TIは各OMAPプラットフォーム間でソフトウェアを再利用できるよう、高いレベルの互換性を組み込みましたので、すべての市場セグメントに対応する完全なマルチライン製品ファミリーを実現する上で最も効果的な選択肢となっています。

注意深く選定されたペリフェラル群はシステムのBOM(原材料費)および基板実装面積を低減すると同時に市場への投入時間を短縮します。

携帯端末の設計において、オペレーティング・システムの移植をはじめとする、最適化されたソフトウェアが用意されていることは必須事項です。TIでは主要なすべてのオペレーティング・システムに最適化されたOMAPリファレンス・ソフトウェア、

重要なドライバのサポート、およびDSPによって高速化された各種コーデック、また包括的なオープン・ソフトウェア開発環境として、高級言語、サードパーティ・アプリケーション、マルチメディア・コンポーネント、ビルディング・ブロックの基本アルゴリズム、ソフトウェア開発ツールを実行するホストへのサポートが提供されています。さらに、サードパーティ各社によるTIの「OMAPデベロッパー・ネットワーク」は、製造各社が製品の差別化のために容易に組み込みできる革新的なアプリケーションおよびメディア・コンポーネントの幅広い選択肢としてご利用いただけます。



OMAP™ 3 プラットフォーム

TIのOMAP3プラットフォームは、多彩なマルチメディア機能を誇るOMAP2プロセッサをベースに構築され、さらに高性能なエンターテインメントおよびPCに匹敵するプロダクティビティ・アプリケーションまでもサポートする新たな拡張を行いました。業界で初めてARM® Cortex™ -A8プロセッサ・アーキテクチャを搭載したOMAP3プラットフォームは、ARM11™ プロセッサと比べ、3倍のARM処理性能を発揮します。また、DSPベースのIVA™ 2+アクセラレータは、従来のOMAPによるマルチメディア処理と比べ4倍の性能を提供します。

OMAP3プロセッサはOpenGL® ES 2.0およびOpen VG™ をはじめとする最先端のグラフィクス標準規格向けに完全なシステム・ソリューションを提供します。これらのオープンなグラフィクス標準規格をサポートしたことで、端末開発各社はハリウッド映画に匹敵する高レベルな画像効果をほどこすツール群を使用できます。以前にはPCおよびゲーム機上でのみ可能であったいきいきとした表情や、さまざまなテクスチャの背景などをはじめとした豊富な視覚効果をモバイル環境で実現できるのです。

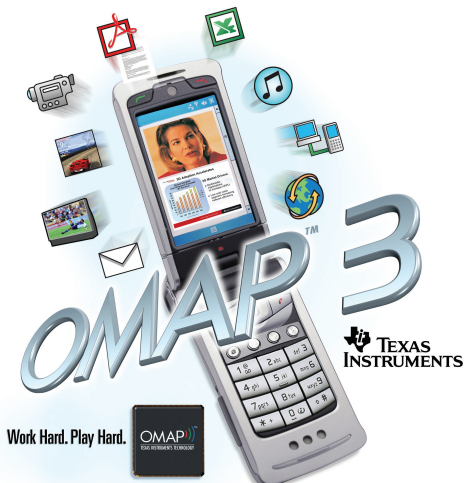
OMAP3ファミリーはハイエンド・マルチメディア対応端末をターゲットとするOMAP3430、中レベルのマルチメディア対応端末をターゲットとするOMAP3420、そして基本的なマルチメディア対応端末向けのOMAP3410で構成されています。また、これらは前世代のOMAPテクノロジーとの間でソフトウェア互換性を保持しています。

OMAP3ファミリーは、最先端のシリコン・テクノロジーであるTIの65nm(ナノメートル)CMOSプロセスにて設計された業界初のアプリケーション・プロセッサであり、モバイル・コミュニケーションの革新を進めていくというTIのコミットメントを反映したものです。

OMAP3プロセッサ・ファミリーは、従来のOMAP2プラットフォームよりも高速に動作可能でありながら、コア電圧の低減および追加された低消費電力化機能によりバッテリー動作時間を延長しています。OMAP3は、市場で最も進歩し、かつ最も高効率の適応型パワー・マネージメント技術であるSmartReflex™ テクノロジーを徹底的に活用しており、デバイスの処理量、動作モード、温度などに基づいて、コア電圧、周波数、電力を動的に制御します。

OMAP3プロセッサはLinux®、Microsoft® Windows Mobile®、Symbian™ をはじめとするHLOS(ハイレベル・オペレーティング・システム)をサポートしています。

また、内蔵のM-Shield™ セキュリティ・テクノロジーはARM TrustZone™ のサポートによって強化されており、各種サービスにおけるコンテンツ保護、トランザクションのセキュリティ、安全なネットワーク・アクセス、それにセキュアなフラッシング/ブート、端末ID保護、ネットワーク・ロック保護をはじめとする端末セキュリティ機能などを可能にします。OMAP3ファミリーは、仕事と遊びの両分野で携帯通信を革新する魅力的なモバイル・アプリケーションの新分野を切り拓きます。



高性能マルチメディア・リッチ・アプリケーション・プロセッサ

OMAP3430プロセッサ

2命令同時実行可能なARM® Cortex™-A8コアを搭載したOMAP3430アプリケーション・プロセッサはARM11ベースのプロセッサに比較して最高3倍の高性能を提供し、3G端末においてラップトップPCに迫るプロダクティビティと最先端のエンターテインメントを実現します。OMAP3430は65nm CMOSプロセス・テクノロジーで設計された業界初のアプリケーション・プロセッサであり、最先端のテクノロジーと革新性を最適に併せ持った、市場で最も進歩したアプリケーション・プロセッサです。65nm CMOSプロセスで設計されたことにより、OMAP3430プロセッサは前世代のOMAP2プラットフォームよりも高い周波数で動作すると共に、コア電圧の低減および新たに加えられた消費電力低減機能によりバッテリー動作時間を延長します。

TIのDaVinci™ テクノロジーに使用されている第二世代の「IVA™ 2+」イメージング/ビデオ/オーディオ・アクセラレータは、低消費電力に最適化されており、またマルチメディア処理において従来のOMAPプラットフォームと比較して最高4倍の性能環境を提供します。向上したIVA™ 2+アクセラレータの処理能力により、MPEG-4、H.264、Windows® Media Video®、

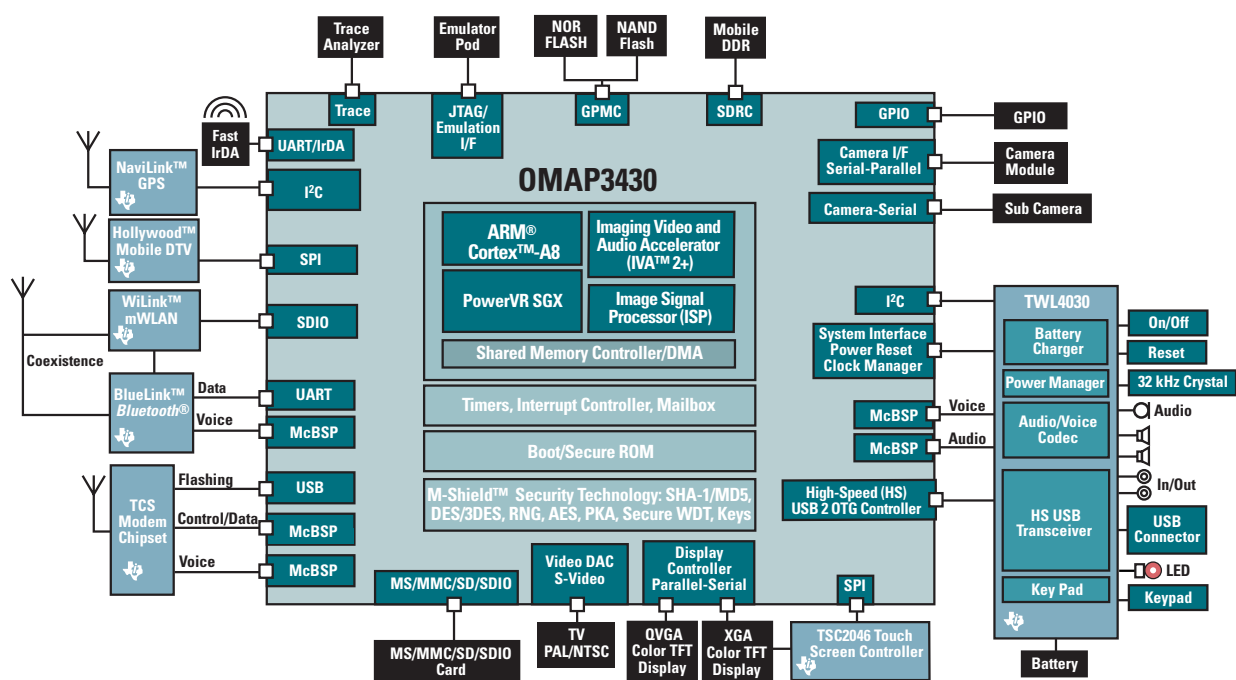
OMAP3430プロセッサの主な特長と利点

- 業界で初めて最先端のスーパー scaler ARM® Cortex™-A8 RISCコアを組み込んだプロセッサ、最高3倍の性能を提供
- 業界初、65nm CMOS プロセス・テクノロジーで設計、高い処理能力を提供
- IVA™ 2+ アクセラレータでMPEG-4、WMV9、RealVideo®, H.263、H.264をはじめとする複数の標準規格でD1 (720x480ピクセル) 解像度、30fps (フレーム/秒) によるエンコード/デコードを実現
- 内蔵ISP (イメージ・シグナル・プロセッサ) がより高速/高品質のイメージ・キャプチャを実現、またシステム・コストも低減
- 柔軟なシステム・サポート
 - ▶ コンポジットおよびS-ビデオのTV出力
 - ▶ XGA (1024x768ピクセル)、1600万色 (24ビット) のディスプレイをサポート
 - ▶ Flatlink™ 3G規格に準拠したシリアル・ディスプレイおよびパラレル・ディスプレイをサポート
 - ▶ ハイスピードUSB 2.0のOTG (On The Go) をサポート
- HDD (ハードディスク・ドライブ) デバイスとのシームレスな接続を提供し大容量記憶を実現
- SmartReflex™ テクノロジーを活用、さらなる消費電力の低減を達成
- ARM TrustZone™ によって強化されたM-Shield™ モバイル・セキュリティのサポート
- 先行のOMAP2プロセッサとソフトウェア互換性を保持
- HLOSサポートにより、インターフェイスをカスタマイズ可能
- OMAP3プロセッサに最適化されたTWL4030パワー・マネージメント・コンパニオン・チップ

RealVideo® をはじめとする複数の標準規格においてDVD品質の解像度でエンコード/デコードを実現します。進歩したマルチメディア機能によって、業界で初めて複数の標準規格に対応するDVD解像度のビデオカメラ機能を携帯電話に搭載できるようになりました。さらに、ARMのベクトル浮動小数点アクセラレーションとOMAP™ 3430に集積された2D/3Dグラ

フィクス・ハードウェア・アクセラレータの組み合わせによって、他に例のないほどリアルなゲーム機能を提供します。

その他システム機能として、イメージ信号プロセッサの内蔵 (ISP)、パラレルおよびシリアルのディスプレイおよびカメラのサポート、コンポジットおよびS-ビデオTV出力、ハイスピードUSB 2.0 OTGのサポートなども備えています。



高性能マルチメディア・リッチ・アプリケーション・プロセッサ

OMAP3420プロセッサ

OMAP3420は性能とコストを適切に配分し、中レベルのマルチメディア対応端末市場のニーズを満足する性能を提供します。OMAP™ 3420はOMAP™ 3430やOMAP™ 3410と同様に65nm CMOSプロセスで設計されたことにより、よりも高い周波数での動作を実現し、さらにコア電圧および消費電力の低減します。またスーパースケーラARM® Cortex™-A8マイクロプロセッサ・コアを組み込むことにより他に例のない性能を発揮し、ラップトップと同様のプロダクティビティならびエンターテインメントを、中レベルのマルチメディア対応端末市場向けの価格帯で提供できます。

OMAP3420プロセッサに内蔵されたIVA™ 2イメージング/ビデオ/オーディオ・アクセラレータにより、MPEG-4、H.264、Windows Media Video、RealVideo®をはじめとする複数の標準規格においてVGA解像度によるビデオカメラとビデオ再生機能を実現します。OMAP™ 3420はOMAP™ 3430と同様に、2D/3Dグラフィクス・ハードウェア・アク

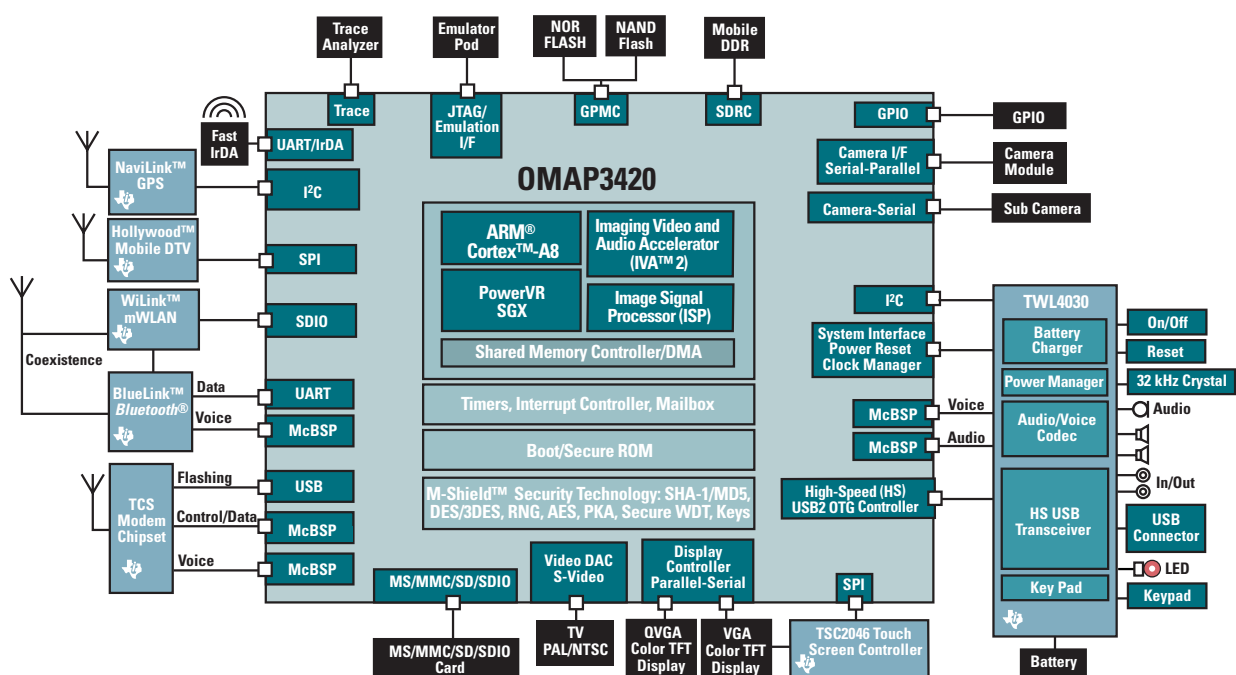
OMAP3420プロセッサの主な特長と利点

- 最先端のスーパースケーラARM® Cortex™-A8 RISCコアを内蔵
- 65nm CMOS プロセス・テクノロジーにより、高い処理能力を提供
- IVA™ 2 アクセラレータにより、複数のビデオ標準規格においてVGA解像度のビデオ再生
- 内蔵のISP (イメージ・シグナル・プロセッサ) がより高速で高品質のイメージ・キャプチャを実現し、システム・コストも低減
- 柔軟なシステム・サポート
 - ▶コンポジットおよびS-ビデオのTV出力
 - ▶VGA (640x480ピクセル)、1600万色(24ビット)のディスプレイをサポート
 - ▶Flatlink™ 3G規格に準拠したシリアル・ディスプレイおよびパラレル・ディスプレイをサポート
 - ▶ハイスピードUSB 2.0 OTGをサポート
- HDDデバイスとのシームレスな接続を提供し大容量記憶を実現
- SmartReflex™ テクノロジーを活用、さらなる消費電力の低減を達成
- ARM TrustZone™ によって強化されたM-Shield™ モバイル・セキュリティのサポート
- 先行のOMAP™ 2プロセッサ、および他のOMAP™ 3プロセッサとの間でソフトウェア互換性を保持
- HLOSサポートにより、インターフェイスをスタマイズ可能
- OMAP™ 3プロセッサに最適化されたTWL4030パワー・マネージメント・コンパニオン・チップ

セラレータを内蔵し、高品質のOpenGL® ESゲーム機能を提供します。

他のシステム機能として、最高500万ピクセルのステル・イメージのキャプチャを可能にするイメージ信号プロセッサ(ISP)、パラレルおよびシリアルディスプレイとカメラのサポート、コンポジットおよびS-ビデオ

TV出力、ハイスピードUSB 2.0 OTGのサポート、シームレスなHDDインターフェイスなども備えています。さらに、OMAP™ 3420はOMAP™ 2およびOMAP™ 3のすべてのプロセッサとの間でソフトウェアの互換性を備えており、スケーラビリティをフルに備えたソリューションを実現します。



高性能マルチメディア・リッチ・アプリケーション・プロセッサ

OMAP3410プロセッサ

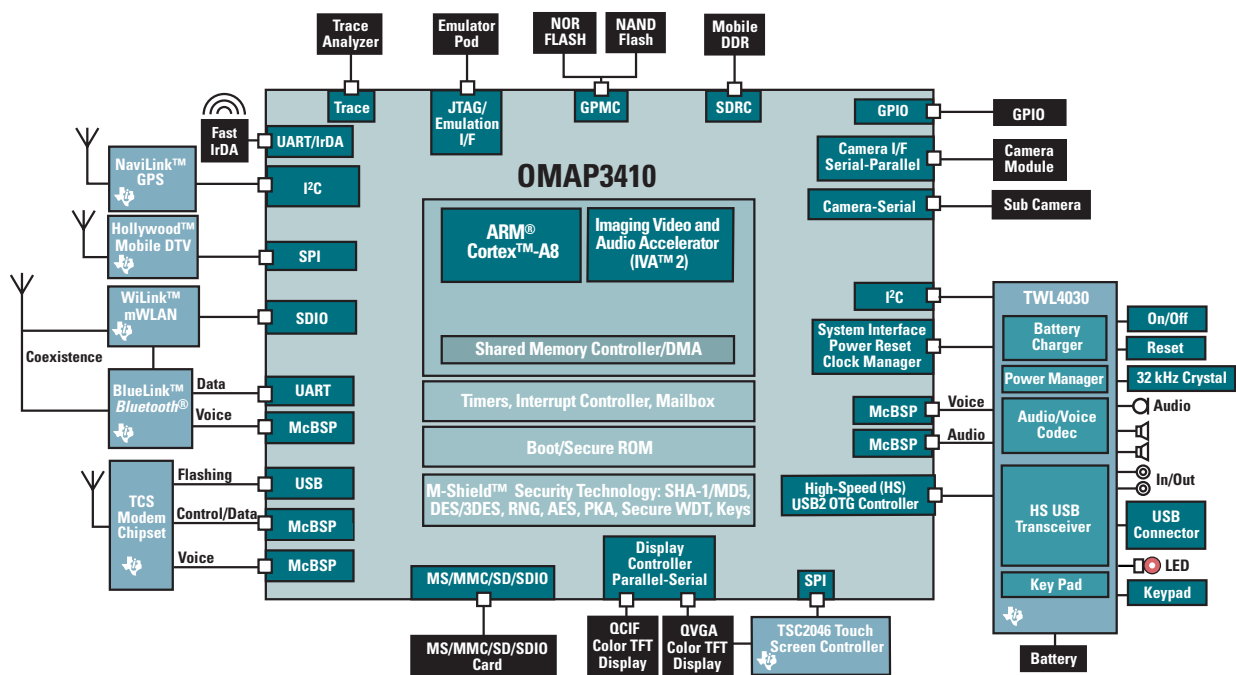
OMAP3410は、MPEG-4、Windows® Media Video® 9、RealVideo®、H.264をはじめとする複数の標準規格でCIF品質のビデオカメラおよび再生機能、最高300万ピクセルのスチル・イメージのキャプチャ、音楽再生や3Dゲームといった、基本的なマルチメディア対応端末市場のニーズを満たすよう設計されています。OMAP™ ファミリの中で最も低コストな製品であるOMAP3410は、65nm CMOSプロセス、スーパースケーラARM® Cortex™-A8マイクロプロセッサ・コア、それにIVA™ 2イメージング/ビデオ/オーディオ・アクセラレータなど、上位製品であるOMAP3420および

OMAP3410プロセッサの主な特長と利点

- 最先端のスーパースケーラARM® Cortex™-A8 RISCコアを内蔵
- 65nm CMOSプロセス・テクノロジーにより、高い処理能力を提供
- IVA™ 2 アクセラレータにより、複数のビデオ標準規格でCIF解像度のビデオ再生
- HDDデバイスとのシームレスな接続を提供し大容量記憶を実現
- SmartReflex™ テクノロジーを活用、さらなる消費電力の低減を達成
- ARM TrustZone™ によって強化されたM-Shield™ モバイル・セキュリティのサポート
- 先行のOMAP™ 2プロセッサ、および他のOMAP™ 3プロセッサとの間でソフトウェアの互換性を保持
- HLOSをサポート、インターフェイスのカスタマイズが可能
- OMAP3プロセッサに最適化されたTWL4030パワー・マネージメント・コンパニオン・チップ

OMAP™ 3430と共通の各種テクノロジーを内蔵しており、豊富なマルチメディア体験と、携帯電話アプリケーションの汎用処理を実現できます。さらに、OMAP™

3410はOMAP™ 2およびOMAP™ 3のすべてのプロセッサとの間でソフトウェアの互換性を備えており、スケーラビリティをフルに備えたソリューションを実現します。



TCS2305 GSM LoCost ULCおよびTCS2315 GPRS LoCost ULCチップセット

TCS2305

TCS2305(GSM)およびTCS2315(GPRS)は、TIのワンチップ第三世代ULC(ウルトラ・ロー・コスト)ソリューション・ファミリの製品です。LoCost ULCソリューションは携帯端末のULC市場セグメントにおいて、多機能でエンドユーザーにアピールする新しい標準をうち立てました。最先端の65nmプロセス・テクノロジー、TMS320C54x™ DSP、強力なARM7™ コアの組み合わせに、市場をリードするTIのDRP™ テクノロジーを導入したことによって、LoCost ULC端末は、最も価格に敏感な市場セグメントにおいて高性能、ロバストな機能、革新的な少実装面積が可能になりました。

LoCost ULCソリューションのTCS2305およびTCS2315は、インド、中国、ブラジル、ロシアなどの地域の急成長市場向けに最適化されています。これら、高い柔軟性とスケーラビリティを備えたソリューションは、最も低価格のカラー携帯端末を実現するだけでなく、より成熟した市場においてバリュー重要視の製品セグメントにも対

TCS2305 GSMソリューションの利点

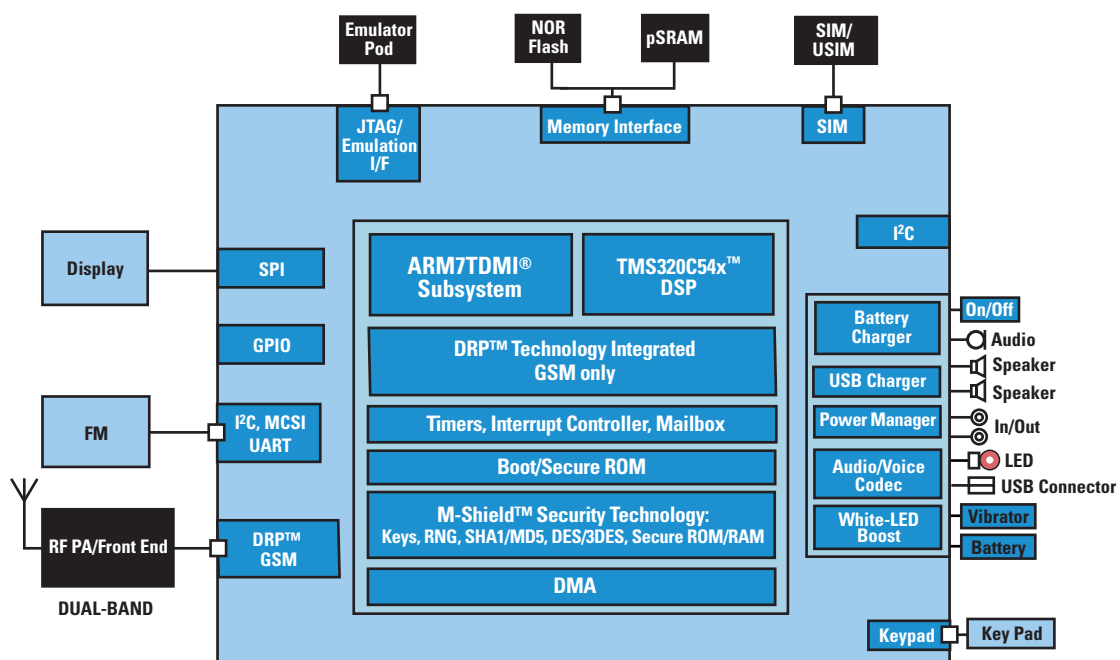
- 65nmプロセスによる、アドバンスドDSP、ARMテクノロジー
- DRP™ テクノロジーを内蔵したワンチップ・ソリューション
- 魅力的な次世代端末のユーザ体験をULC端末で提供
 - ▶ 外付けSRAMなしに、最も低価格のカラー端末を実現(128x160ピクセル、65,000色のディスプレイ)
 - ▶ 高速処理CPUによって、スムーズなユーザ・インターフェイス処理
 - ▶ CD品質(44.1kHz)のMP3着信メロディおよび、多重音源の着信メロディ
 - ▶ ハイエンドの全二重音声品質
 - ▶ FMステレオデバイスとの接続サポート
 - ▶ FMをオンザフライ方式で録音、着信メロディとして使用
- 従来と比べ部品点数および基板実装面積を削減する最適化されたシステム設計
 - ▶ eBOM(電子部品の原材料費)を25%以上削減
 - ▶ 全体的な部品点数をおよそ40%削減
 - ▶ 基板実装面積を最高35%削減する小型モジュール
- ユニバーサルで使いやすいUSB充電機能
- 低消費電力化により通話時間を30%、待機時間を60%向上
- プリント基板の小型化により、革新的な端末形状、より大きなバッテリー搭載が可能

応します。

シングルチップ・ワイヤレス端末ソリューションとして実績あるTIのLoCost製品ファミリが確立した高性能を、LoCost ULCソリューションはさらに拡張します。これえまでのLoCostソリューションから次世代であるLoCost ULCへの移行は高いソフ

トウェア移植性があります。そのため、ハンドセット製造各社および通信事業者は言語、地域、加入者タイプを越えて、急成長市場と成熟市場のいずれにも高いコスト・パフォーマンスで差別化した製品およびサービスを提供できます。

TCS2305 “LoCosto ULC” GSM



TCS2305 GSM LoCost ULCおよびTCS2315 GPRS LoCost ULCチップセット

TCS2315

ULC端末に最も豊富な機能セットを提供

LoCost ULCソリューションのTCS2305およびTCS2315は、従来よりはるかに豊富なULC機能を有するハンドセットを実現するために、強力な処理能力を備えています。

これらのソリューションによってULC端末で可能になった拡張機能には、外付けSRAMなしで比較的高解像度のカラー・ディスプレイの搭載、ハイエンドの全二重音声品質、CD品質に迫るMP3および多音源の着信メロディ、通話時間および待ち受け時間の延長、ステレオFMラジオ、VGAカメラのサポート、MP3再生と大容量記憶デバイス(SD/MMC)のサポート、USB接続およびUSBからの充電、ハンドフリー・スピーカーフォン動作、着信バイブレータ、ヘッドセット・サポート、Bluetooth® 接続など、多彩な機能などがあります。

持続可能な低価格構造

LoCost ULCソリューションが継続的な低価格構造を維持できるのは、いくつかの

TCS2315 GPRSソリューションの利点

- TCS2305 GSMソリューションの利点のほか、
 - ▶GPRS機能
 - ▶VGAカメラのサポート機能を内蔵、JPEGのエンコード/デコード機能、回転、ズームその他アドバンスド・イメージング機能
 - ▶豊かな音楽再生を提供するCD品質のMP3ステレオ再生機能
 - ▶PC/端末間のデータ伝送をおこなうUSB接続
 - ▶MP3ミュージック、着信メロディ、データ、通話などを格納できる大容量記憶デバイス(SD/MMC)サポート
 - ▶ステレオ・ヘッドセットなど、利用価値の高いBluetooth® デバイス接続

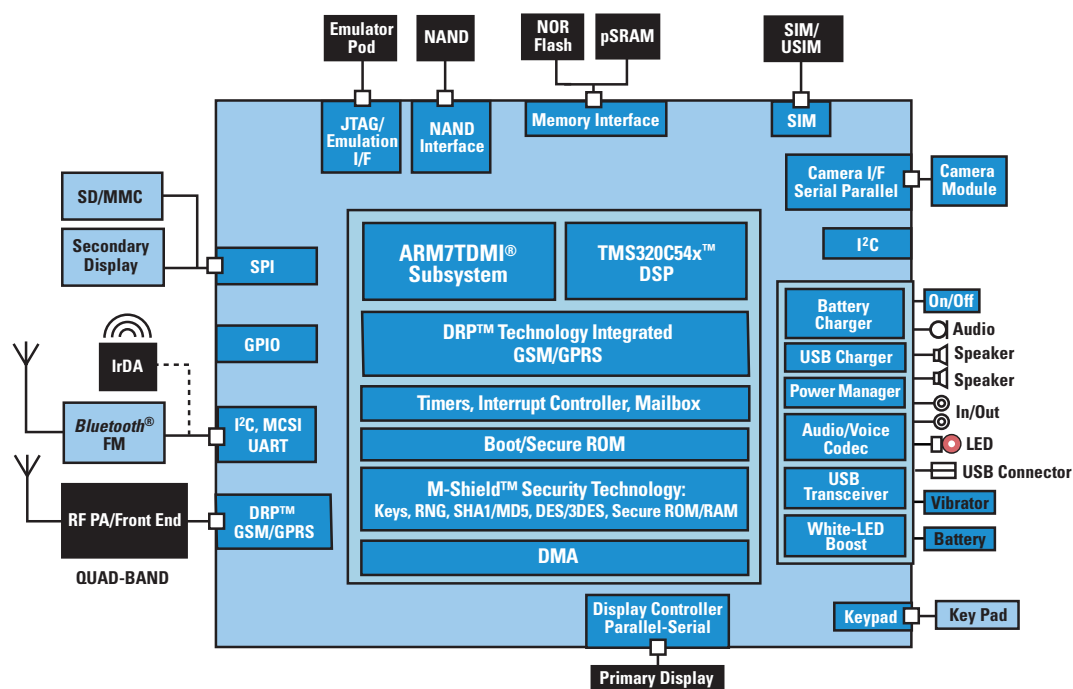
チップ・レベルおよびシステム・レベルの要因が寄与しています。これら要因として、65nmプロセス・テクノロジーを筆頭にULC端末のeBOMを25%低減、小型パッケージおよび高集積化による基板実装面積の低減、コストに最適化したプリント基板技術などのコスト最適化技術が挙げられます。パワー・マネジメントとデジタル・ベースバンドの両機能をワンチップに集積することで、モデム部分の基板実装面積も低減しました。

RF部分も含めワンチップ化したことも、基板実装面積および部品点数の低減に寄与しています。チップ数の低減、小型のプリント基板、高い集積度、アドバンスド・パッ

ケージ技術によって、革新的でファッショナブルな形状の端末を実現できます。また、プリント基板の小型化によって大きなバッテリーを端末に搭載することが可能となり、長い待機時間、通話時間およびより長いバッテリー動作寿命を実現できます。

低価格の端末にも、ハードウェア・ベースでスケーラブルなTIのM-Shield™ セキュリティ・テクノロジーによる保護機能を搭載できます。LoCost ULCソリューションのM-Shield機能は端末所有者の重要な個人情報情報を安全に保護するとともに、端末のSIMlockコードを解除しようとする試みを排除します。

TCS2315 “LoCosto ULC” GPRS



Bluetooth®

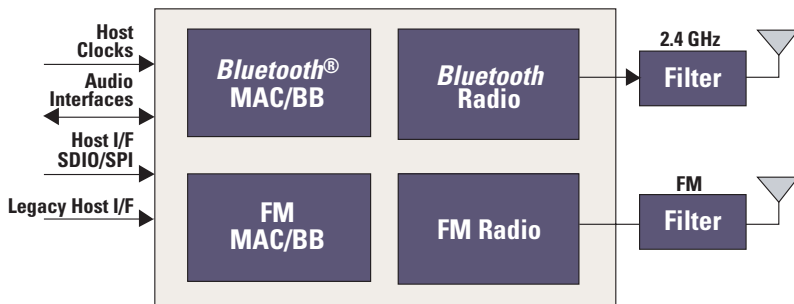
BlueLink™ 7.0シングルチップBluetooth® およびFM RX/TXソリューション

BL6450は業界初の65nm CMOSプロセスによるBluetoothソリューションです。BluetoothおよびFM送受信の完全なHW & SWソリューションを提供するので、携帯機器メーカーは、設計が容易になるとともに設計期間を短縮できます。Bluetooth機能にはBluetoothスเปック 2.1+EDRをサポートするTIの第5世代Bluetoothコアが使用されています。また、FM機能は最新技術によって、低消費電力、ステレオSNR、感度などの高いFM性能が実現されています。

BluetoothとFM機能が同一シリコンに集

積されているため、FMとの共存が最適化されており、二つの機能は同時に動作可能となります。Bluetoothがどんなモードで動作している時でもFM受信、スキャン、RDS情報の送信が可能です。

さらに、BlueLink7.0では、FCC/ETSIなどの規格を満たすため、プログラマブルなFM送信電力をサポートします。TIのDRP (Digital Radio Processing) 技術と 65nm プロセス技術により、BL6450は業界最小のBluetooth+FM1チップ・ソリューションを実現しました。外付け部品点数が極めて少なく、ディスクリート



主な特長

- 65nm CMOS プロセスと DRP™ 技術を使用した低消費電力、低コスト、業界最小のBluetooth+FMソリューション
- Bluetoothスเปック 2.1+EDRサポート
- FM送受信、RDS (Radio Data System)、US/ヨーロッパ/日本のFMバンドの完全サポート
- 携帯電話システムへの最適化
- バッテリー持続時間を延ばす先進的な電源管理
- さまざまなホストシステムへの接続が容易なインターフェイス
- Bluetooth/FMの同時動作

ソリューションに比較してインターフェイスの数が少ないので、お客様はコストとサイズを削減できます。

BL6450は、TIのBluetooth/WLAN共存ソリューションが組み込まれているため、TIのWiLinkソリューションとの最適なインターフェイスを提供します。TIの共存ソリューションはVoIP over WLANとBluetooth音声をつつのアンテナで実現することができます。

Wireless LAN

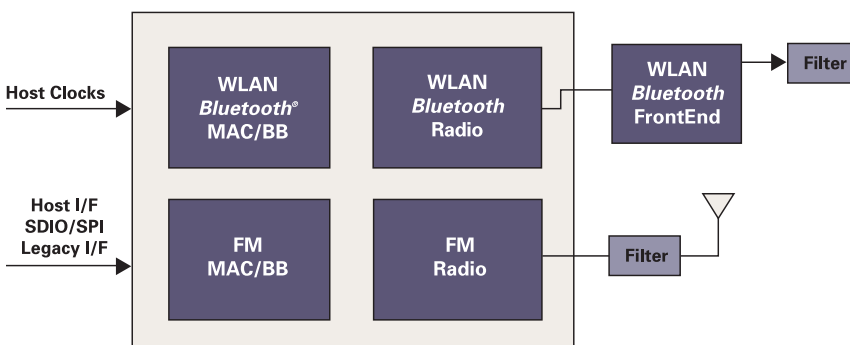
WiLink™ 6.0シングルチップWLAN, Bluetooth® およびFMソリューション

TIのWiLink6.0プラットフォームは実績のある、キャリア品質のWLAN、Bluetooth、FMを1チップに集積しました。このソリューションには、802.11b/g/nをサポートするWL1271、802.11a/b/g/nをサポートするWL1273の二つの製品があります。どちらの製品もBluetooth2.1+EDRとFM送信および受信機能をサポートしています。

WiLink6.0シングルチップ・ソリューションは65nm CMOSプロセスで製造され、TIの

DRP技術が使われています。ハンドセットメーカーが求める低消費電力、最小サイズ、低コストを実現することが可能です。

WiLink6.0ソリューションは、実績のあるBluetooth/WLAN共存プラットフォームを含んでいます。この共存機能はハンドセットにとってますます重要になっています。TIはこの共存プラットフォームを使ったハンドセットをこれまで30機種以上市場に投入し、この分野をリードしてきました。



主な特長

- 65nm CMOS プロセスと DRP™ 技術を使用した1チップWLAN、Bluetooth、FMソリューション
- 実績のあるキャリア品質のWLAN (802.11a/b/g/n)、Bluetooth 2.1+EDR
- 通話時間とバッテリー持続時間を向上させるELP™ 低消費電力化技術
- それぞれの機能の同時動作を可能にする実績のある共存ソリューション

WiLink6.0ソフトウェア開発キット(SDK)には、携帯電話アプリケーションに最適化されたWiLink6.0ソリューションが含まれています。これには、Linux®、Windows®、WinCE®、Symbian™ の各OSサポート、ラボ試験用ソフトウェア、製造ライン用ソフトウェアが含まれ、モバイル・アプリケーションにおけるCPU負荷と消費電力を最小にするよう設計されています。

GPS

NaviLink™ 5.0 シングルチップ GPS ソリューション

GPS機能は多くの携帯機器に搭載され、同様の機能が携帯電話へも要求されるようになってきました。

NL5350 NaviLink™ 5.0 シングルチップ・ソリューションは、携帯電話に最適化され、モバイルナビゲーション、3Dマップ、位置情報サービス、セキュリティサービスなどを提供することができます。NL5350は90nm CMOSプロセスで製造され、TIのDRP技術が使用されています。DRP技

術はディスクリット・ソリューションと比較して、最小サイズ、低価格、低消費電力、高性能を携帯電話メーカーに提供します。

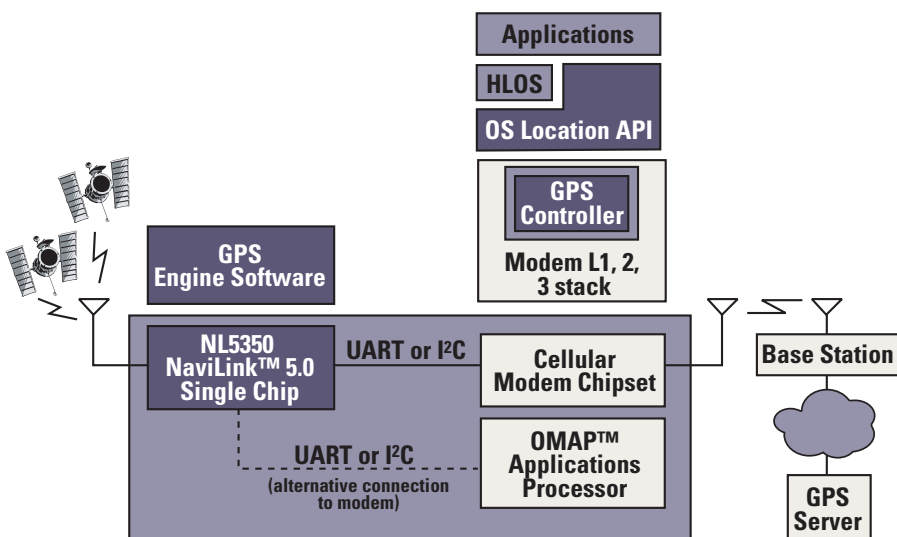
- ・最小サイズ: NL5350 NaviLink5.0 ソリューションは、完全なGPSシステムを1チップに集積し、ボードレイアウトエリアを大幅に削減、約25mm²で実現可能になります。
- ・低コスト: これまでのソリューションでは30個の外付け部品が必要でしたが、

主な特長

- ・90nm CMOSプロセスとDRP™ 技術を使用した1チップGPSソリューション
- ・最小のGPSソリューション(エリアサイズ約25mm²)
- ・極めて少ない外付け部品(11個)
- ・電源管理機能を内蔵した低消費電力
- ・高いGPS性能(3GPP、3GPP2の要求を上回る)
- ・OMAPとの最適化されたインターフェイスで完全なソリューションの提供

NL5350では半分以下のわずか11個の受動素子で済みます。

- ・低消費電力: NL5350には電源マネージメントも集積されていますので、設計が容易で外付け部品が少なく済みます。また、バッテリーの直付けが可能なので、携帯電話の設計には最適です。
- ・高性能: NL5350は、3GPP、3GPP2の要求仕様を上回る、インドアなどでの微弱な信号レベルでの高速な測位時間(TTFF)などベスト・イン・クラスの性能を誇ります。



※黒と赤のパナーデザイン、Technology for Innovators、OMAP、M-Shield、SmartReflex、IVA、DaVinci、Bluelink、Wilink、Navilink、Flatlink、DRP、TMS320C54xは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
※その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

お問い合わせ先

日本TIプロダクト・インフォメーション・センター (PIC)
URL: <http://www.tij.co.jp/pic/>

本社

〒160-8366 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル
☎ 03 (4331) 2000 (番号案内)

西日本ビジネスセンター

〒530-6026 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30 OAPオフィスタワー26階
☎ 06 (6356) 4500 (代)

工場

大分県・日出町 / 茨城県・美浦村
神奈川県・厚木市 (厚木テクノロジー・センター)
茨城県・つくば市 (筑波テクノロジー・センター)

S-0107

ご注意:

本資料に記載された製品・サービスにつきましては予告なしにご提供の中止または仕様の変更をする場合がありますので、本資料に記載された情報が最新のものであることをご確認の上ご注文下さいようお願い致します。
TIは製品の使用用途に関する援助、お客様の製品もしくはその設計、ソフトウェアの性能、または特許侵害に対して責任を負うものではありません。また、他社の製品・サービスに関する情報を記載していても、TIがその他社製品を承認あるいは保証することにはなりません。

